

股票简称：伟测科技

股票代码：688372



**关于上海伟测半导体科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的
审核问询函的回复**

保荐机构（主承销商）



（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二六年九月

上海证券交易所：

贵所于 2026 年 9 月 1 日出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2026）200 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉，上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“伟测科技”）会同平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，发行人已披露 2026 年半年度报告，本回复相关分析、数据更新至 2026 年 6 月 30 日，现回复如下，请审核。

如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相同含义。

字体	含义
黑体加粗	审核问询函所列问题
宋体	对审核问询函所列问题的回复、中介机构核查情况

在本审核问询函问题回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目 录

目 录.....	2
问题 1 关于本次募投项目	3
问题 2 关于业务与经营情况	39

问题 1 关于本次募投项目

根据申报材料：（1）本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本数），用于伟测科技上海总部基地项目、伟测科技西南总部及研发测试基地项目以及偿还银行贷款及补充流动资金；报告期内，公司产能利用率分别为 63.27%、76.79%、74.19%和 72.49%；（2）伟测科技西南总部及研发测试基地项目尚未取得土地使用权证，前次募投项目“高端芯片测试”包含 AI 算力芯片。

请发行人说明：（1）上海基地及西南总部晶圆测试与芯片成品测试产能占比差异，实施本次募投项目的主要考虑及必要性；本次募投项目与前次募投项目、现有业务的区别与联系，本次募投是否存在新产品，本次募集资金是否符合投向主业相关要求；（2）结合本次募投产品的研发进展、客户验证、设备采购等，说明实施本次募投项目的可行性；（3）结合募投产品的现有产能及规划产能情况、募投产品产能利用率、在手订单及意向订单、客户开发、前次募投项目产能爬坡进展及是否存在产能闲置等，说明新增产能消化的合理性，相关风险揭示是否充分；（4）伟测科技西南总部及研发测试基地项目土地预计取得计划及时间，相关投资协议包含的效益指标是否存在无法达成的风险并补充风险提示；（5）本次募投项目各项投资构成情况、测算过程及测算依据，相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目的对比情况，是否存在重大差异；（6）本次募投项目效益测算中测试单价、时长等指标选取的主要依据，与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异，新增折旧摊销对公司未来业绩的影响，本次效益测算是否谨慎、合理；（7）结合公司货币资金余额、资产负债结构等，说明本次融资的必要性、融资规模的合理性。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（4）进行核查并发表明确意见，请申报会计师核查问题（5）-（7）并发表明确意见。

【回复】

一、上海基地及西南总部晶圆测试与芯片成品测试产能占比差异，实施本次募投项目的主要考虑及必要性；本次募投项目与前次募投项目、现有业务的区别与联系，本次募投是否存在新产品，本次募集资金是否符合投向主业相关要求

（一）上海基地及西南总部晶圆测试与芯片成品测试产能占比差异

上海基地及西南总部拟购置设备明细、测试产能情况如下表所示：

单位：台、万小时

设备分类	上海项目		西南项目		合计	
	机台数量	测试产能	机台数量	测试产能	机台数量	测试产能
测试机	70	54.43	90	69.98	160	124.41
探针台	35	-	45	-	80	-
分选机	35	-	45	-	80	-
合计	140	54.43	180	69.98	320	124.41

注：探针台、分选机需与测试机搭配进行测试，无法单独运行，故测试产能计算时仅统计测试机数量，为简化计算，全年测试天数取 360 天，测试产能=测试机台数量*24*360*90%

本次募投项目拟采购设备包含测试机、探针台、分选机三类。其中，测试机为共用核心设备，搭配探针台可实现晶圆测试，搭配分选机可实现芯片成品测试；探针台、分选机分别对应两类测试工序。

募投项目探针台与分选机按 1:1 配置，在规划阶段将总测试产能 124.41 万小时均衡分配，即晶圆测试、芯片成品测试规划产能均为 62.21 万小时。

项目规划阶段基于设备配比假设均衡分配产能，但测试机可在探针台、分选机之间灵活调配。项目投产后，公司将结合下游订单结构及实际产能需求变化，动态调整测试机分别与探针台、分选机的组合方式，灵活分配晶圆测试、芯片成品测试的实际产出，匹配业务实际生产需要。

（二）实施本次募投项目的主要考虑及必要性

1、实施本次募投项目的主要考虑

本次上海及西南募投项目均面向 AI 算力芯片测试、存储芯片测试及高端 CIS 芯片测试三大测试领域实施，均通过购置对应测试领域所需测试机满足扩产的需求。

公司本次募投分别在上海和成都两地实施，主要基于土地资源约束、全国产业布局规划、客户服务等多方面综合考量，具体原因如下：①上海是全国最大的集成电路产业集群，也是公司总部所在地，公司在上海总部的生产和办公均为租赁厂房，受制于土地供应紧张等原因，过去几年上海总部一直未进行产能扩张。2025 年，公司获得扩产所需的土地，启动了“伟测科技上海总部基地项目”，一方面能够满足上海及周边地区 AI 算力芯片客户的测试需求，另一方面借此机会改善总部的办公环境和研发人员的办公条件。②西南地区已形成较为完整的集成电路产业链，集聚大量集成电路芯片设计客户以及华虹成都、德州仪器、英特尔等晶圆制造、封测企业，而当地尚未出现较大规模的第三方测试企业，竞争格局良好。因此，公司建设成都基地，能够就近配套西南地区晶圆制造及芯片设计产业集群，缩短晶圆/芯片的运输距离，提升订单响应与交付效率。本次布局补齐公司西南区域产能支点，与现有长三角基地形成全国协同的服务网络。

综上，本次募投分上海、成都两地实施具备商业合理性，符合行业经营特点与公司长期发展战略。

2、实施本次募投项目的背景情况

（1）人工智能成为集成电路产业发展的核心引擎，算力与存储等关键芯片供不应求，配套的先进晶圆代工、先进封装、高端测试的产能亦进入紧缺状态

当前，人工智能已成为驱动集成电路行业高质量发展的核心引擎，大模型训练与推理需求的爆发式增长，直接推动算力芯片、高带宽存储芯片等关键产品需求快速增长、供不应求。在此背景下，与之深度配套的先进晶圆代工、2.5D/3D 先进封装及高端测试环节产能同步进入紧缺状态，产业链上下游协同扩产迫在眉睫。尤其随着芯片制程微缩与异构集成技术演进，测试环节对高端测试设备、复杂工艺适配能力及交付效率提出更高要求，成为制约整体产能释放的关键瓶颈之一。

（2）国产算力迈入爆发期，有望重塑全球高端测试供需格局，为内资测试厂商追赶国际先进水平、实现弯道超车提供难得机遇

CPU、GPU 及 AI 芯片等算力芯片的测试业务具备高壁垒、高单价、高附加值等特征，被誉为测试行业“皇冠上的明珠”。长期以来，算力芯片市场由国外厂

商主导，其测试业务也主要配套于外资封测巨头。随着国产算力芯片从技术验证阶段全面跨入规模化商用爆发期，以华为昇腾、寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份为代表的本土企业在 AI 训练与推理芯片领域持续取得重大突破。在自主可控战略需求推动下，加之算力芯片测试方案需深度定制开发，部分内资龙头测试厂商得以切入国产算力芯片产业链。这一趋势有望深刻改变全球高端测试的供需配套格局，为内资测试厂商对标全球一流水平并实现弯道超车创造历史性契机。

（3）公司是国内较早前瞻性高强度布局 AI 算力芯片测试业务的少数厂商之一，在新一轮 AI 业务竞争中已抢占部分先机

公司较早预判到 AI 算力芯片测试业务将成为重塑行业竞争格局的关键机遇。自 2024 年以来，公司在洁净厂房建设、AI 用高端测试机采购、测试技术突破及客户开发等方面，果断进行了前瞻性的高强度投入。

在洁净厂房建设方面，由于洁净车间建设周期较长，部分国际巨头在本轮 AI 算力芯片测试扩产中面临产能空间不足的制约。而公司自 2023 年起，便无锡、南京持续大力投资高标准、大面积的洁净车间，为后续大规模扩产提供了坚实的厂房保障。

在 AI 用高端测试机采购方面，该类设备长期由爱德万、泰瑞达两家巨头垄断，存在价格高、交期长等问题。AI 业务爆发后，该类设备供应更趋紧张。2024 年以来，公司积极采购 AI 用高端测试机，并通过提前下单锁定了大量未来扩产所需设备。目前，公司已采购及锁定订单的 AI 用高端测试机数量处于国内领先地位。

在 AI 算力芯片测试技术突破方面，公司持续加大研发投入并引进高端测试人才，先后攻克了 CPU、GPU、AI 芯片及智驾芯片等各类 AI 算力芯片的测试难点，已充分具备大规模开展 AI 算力芯片测试业务的技术基础。

在 AI 算力芯片客户开发方面，公司紧跟客户产品研发与量产节奏，历时 2-3 年通过了国内主流 AI 算力芯片客户的供应商认证。2025 年，与公司持续开展业务合作的 AI 算力芯片客户达 10 余家，已覆盖国产算力领域最知名的一批核心客户。

通过上述举措，公司在新一轮 AI 业务竞争中成功抢占先机。AI 算力芯片测试业务已成为公司当前重要的收入来源，亦是驱动业绩高速增长的核心引擎。

3、实施本次募投项目的必要性

（1）继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，将其打造为公司业绩增长的重要引擎，并为我国人工智能行业高端测试能力的自主可控提供有力保障

过去两年，面对人工智能产业爆发式增长带来的 AI ASIC 芯片、GPU、CPU 等 AI 算力芯片测试需求，公司坚持前瞻性扩产策略，通过引进国际先进测试设备、组建专业测试团队、建设高标准测试产线等举措，全面加码产能布局。截至 2026 年 6 月末，AI 算力芯片测试收入在公司营业收入中的占比已经初具规模。公司预计未来几年，AI 算力芯片测试需求仍将保持爆发式增长的态势。本次募投项目将继续加大 AI 算力芯片测试产能的建设，一方面能够将其打造为公司业绩增长的重要引擎，另一方面能够填补我国在该领域的产能缺口，有助于构建自主可控的测试技术体系，为我国人工智能产业筑牢质量根基，助力国产 AI 算力芯片在全球竞争中掌握核心话语权。

（2）响应现有客户的需求，扩大存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能，增强客户粘性，并增强公司的差异化竞争优势，打造新的业绩增长点

本次募投项目在重点强化 AI 算力芯片测试业务的同时，亦将部分资源倾斜至存储芯片、高端 CIS 芯片测试产能的建设。虽然这两类业务当前并非公司收入的主要来源，但凭借其卓越的成长潜力与有利的竞争态势，加之现有客户旺盛的测试需求，公司已将其视为关键的业务延伸方向。通过本次产能扩充，公司不仅能高效满足现有客户的增量需求，进一步巩固客户基础，更能借此优化业务组合，构建独特的差异化优势，为公司业绩的可持续增长打造新的业绩增长点。

（3）为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司在行业中的领先地位

自 2016 年成立以来，公司的业绩保持了高速增长的态势，截至目前，公司已经发展成为中国大陆第三方集成电路测试领域中的领军企业。随着业务量不断上升，公司需要继续扩充测试产能才能保障业绩的持续增长。此外，集成电路行业具有“大者恒大”的规律，本次募投项目达产之后，预计能够大幅度增加公司的

测试服务能力、营业收入和净利润规模，进一步巩固公司在行业中的领先地位。

综上所述，面对 AI 产业驱动下高端芯片测试需求快速增长的行业机遇，结合公司已形成的先发业务基础，实施本次募投项目具备必要性。

（三）本次募投项目与前次募投项目、现有业务的区别与联系，本次募投是否存在新产品，本次募集资金是否符合投向主业相关要求

1、本次募投项目与前次募投项目的区别与联系

本次募投项目主要投向 AI 算力芯片测试、存储芯片测试及高端 CIS 芯片测试，前次募投项目主要投向“高端芯片测试（包括 AI 芯片在内的高端数字芯片）”和“高可靠性芯片测试（包括车规级、工业级芯片）”。

前次募投项目“高端芯片测试”包含了 AI 算力芯片，两次募投项目的投向在 AI 算力芯片领域存在较大重合，因此在测试类型、目标客户、应用领域等方面存在较大重合，具体的区别和联系如下：

类别	本次募投项目之“AI 算力芯片”方向	前次募投项目之“高端芯片测试”方向	区别与联系
测试芯片具体类型	AI ASIC 芯片、GPU、CPU、智驾芯片	AI ASIC 芯片、GPU、CPU、智驾芯片、各类 SoC 芯片、FPGA 芯片、各类高端数字芯片	两者属于包含关系，前次募投方向范围较广，包含了本次募投的方向和芯片类型
应用领域	AI 数据中心、自动驾驶	AI 数据中心、自动驾驶、消费电子、通信设备、工控设备等	部分应用领域重合
测试类型	CP、FT	CP、FT	测试类型完全相同
目标客户	AI ASIC 芯片客户、GPU 客户、CPU 客户、智驾芯片客户	AI ASIC 芯片客户、GPU 客户、CPU 客户、智驾芯片客户、各类 SoC 芯片客户、FPGA 芯片客户、各类高端数字芯片客户	部分客户群体重合

本次募投项目的存储芯片测试、高端 CIS 芯片测试方向，与前次募投项目的“高可靠性芯片测试”属于不同的方向，因此在测试类型、应用领域、目标客户等方面存在显著区别，具体的区别和联系如下：

类别	本次募投项目之“存储芯片测试、高端 CIS 芯片测试”方向	前次募投项目之“高可靠性芯片测试”方向	区别与联系
测试芯片具体类型	存储芯片：NOR Flash、NAND Flash、DRAM CIS 芯片：高端 CIS 芯片	各类车规级、工业级芯片	差异较大，两者属于不同的分类方法
应用领域	消费电子、通信设备、工控设	汽车电子、工控设备、通	部分大类领域重

类别	本次募投项目之“存储芯片测试、高端 CIS 芯片测试”方向	前次募投项目之“高可靠性芯片测试”方向	区别与联系
	备、汽车电子等	信设备等	合，但具体用途差异较大
测试类型	CP	CP、FT、老化测试	前次募投较本次募投多两项 FT、老化测试
目标客户	存储芯片：兆易创新、普冉股份、东芯股份等 CIS 芯片：客户 A、客户 I	地平线、纳芯微、合肥智芯、杰发科技、禾赛科技等	均是半导体设计公司，但客户群体不同

公司两次募投项目均系根据当时国内集成电路行业的发展阶段及市场需求所作出的审慎的投资决策。

前次募投项目决策主要于 2022 年至 2023 年作出，背景为国内高端测试产能相对紧张，以及新能源电动车的快速发展引起车规级芯片的需求快速爆发，因此公司主要投向“高端芯片测试（包括 AI 芯片在内的高端数字芯片）”和“高可靠性芯片测试（包括车规级、工业级芯片）”，主要保障 2024 年、2025 年和 2026 年公司业绩增长所需要的产能。

本次募投项目的投资决策在 2026 年初作出，其背景是国内 AI 芯片和存储芯片进入前所未有的景气大周期，测试需求十分旺盛，同时高端 CIS 芯片存在卡脖子现象，因此主要投向 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片，主要保障 2027 年及以后年度公司业绩增长所需要的产能。

2、本次募投项目与现有业务的区别与联系

公司是国内知名的第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖 AI 芯片、CPU、GPU、DPU、SoC 芯片、FPGA、MCU、存储芯片、射频芯片、高端 CIS 芯片等芯片种类。

本次募投项目是对公司现有业务的扩产，重点围绕公司现有业务中具有良好发展前景的 AI 算力芯片、存储芯片及高端 CIS 芯片三个细分领域进行产能扩张。

3、本次募投是否存在新产品，本次募集资金是否符合投向主业相关要求

（1）本次募集资金主要投向

公司本次募集资金主要投向 AI 算力芯片测试、存储芯片测试及高端 CIS 芯

片测试三个测试领域，其中以 AI 算力芯片测试为主，AI 算力芯片测试的设备投资金额占比近 80%，存储芯片测试的设备投资占比约 12%，高端 CIS 芯片设备投资占比约 8%。

单位：台、万元、%

投资分类	上海项目			西南项目			合计		
	测试机数量	投资金额	投资占比	测试机数量	投资金额	投资占比	测试机数量	投资金额	投资占比
AI 算力芯片测试	40	31,856.81	76.84	65	37,799.13	80.10	105	69,655.94	78.57
存储芯片测试	25	7,009.66	16.91	15	4,207.26	8.92	40	11,216.92	12.65
高端 CIS 芯片测试	5	2,592.50	6.25	10	5,185.01	10.99	15	7,777.51	8.77
合计	70	41,458.97	100	90	47,191.39	100	160	88,650.37	100

(2) 本次募投是否存在新产品，本次募集资金是否符合投向主业相关要求

本次募投项目不存在新产品。发行人主营业务为第三方集成电路测试服务，本次募投涉及的 AI 算力芯片测试、存储芯片测试及高端 CIS 芯片测试均属于公司现有集成电路测试服务业务，仅为针对不同芯片产品的测试服务细分。本次募集资金投向均用于现有业务的扩产或升级，不存在用于拓展新业务、新产品的情形，符合募集资金应投向主业的要求。

二、结合本次募投产品的研发进展、客户验证、设备采购等，说明实施本次募投项目的可行性

本次募投项目围绕发行人主营业务集成电路第三方测试服务开展，重点扩充 AI 算力芯片、存储芯片及高端 CIS 芯片的测试产能。本次募投产品的研发进展、客户验证、设备采购等，具体情况如下：

(一) AI 算力芯片测试领域

本次募投项目是对公司现有 AI 算力芯片测试业务的扩产，报告期内 AI 算力芯片测试的收入分别为 8,161.64 万元、6,290.85 万元、30,750.06 万元及 21,710.88 万元，服务的 AI 算力芯片客户已有 10 多家。因此，公司在 AI 算力芯片测试业务的技术研发、客户开发、设备采购等方面具有丰富的经验，并已经取得良好的成果，具体情况如下：

1、技术研发进展

公司已经积累了“高性能人工智能芯片测试解决方案”、“高性能区块链算力芯片晶圆测试方案”等一系列核心技术，技术成熟度较高，且已攻克 GPU、CPU、AI 芯片、Chiplet 先进封装、高速接口、大功耗散热、并行测试等关键测试难点，具备完整的 CP 晶圆测试、FT 芯片成品测试、老化 SLT 全流程测试开发能力，已经形成标准化测试代码库与量产验证流程，相关技术已在现有产线实现规模化落地应用。

2、客户验证情况

公司已完成国内 10 余家主流 AI 算力芯片设计企业的供应商资质认证，具体包括 AI ASIC 芯片龙头企业、GPU 新锐厂商、自研 AI 芯片的云计算厂商、智能驾驶 AI 芯片厂商 M 大类客户。此外，公司也与多家 AI 服务器 CPU 厂商建立了稳定的业务合作关系。相关客户已实现批量订单落地，下游客户测试需求旺盛，募投新增产能主要承接存量客户未来增量订单，同时公司积极拓展新客户，部分新增客户已开始贡献收入，另有部分处于技术导入阶段，后续有望逐步放量，具备明确的市场需求基础，截至 2026 年上半年，AI 算力芯片测试收入在公司营业收入中的占比已超过 20%。

3、设备采购储备

本次募投项目的 AI 算力芯片测试方向主要投向晶圆测试和芯片成品测试，需采购测试机、探针台和分选机 3 大类设备。其中，测试机拟采用供应商爱德万、泰瑞达对应的主流测试机型，探针台拟采用供应商东京精密的成熟探针台产品，分选机拟采用供应商鸿劲精密的主流分选设备，上述设备均为公司已经熟练使用的设备，公司与主要设备供应商具有多年良好的合作关系，采购渠道通畅且稳定。

上述设备中，测试机和探针台基本依赖进口，分选机则实现了较高的国产化率，能够很好替代进口产品。截至本回复出具日，本次拟采购的进口测试机、探针台进口渠道保持通畅，设备采购未受到出口管制、贸易限制或其他贸易政策的实质性不利影响。为了防范海外进口设备可能受限的风险，过去几年公司一直提前布局，积极寻找国产替代供应来源，大力支持国产设备厂商的发展，加快国产设备的验证和导入，截至目前公司已经为主要的进口设备均准备了完善的国产替

代方案。在本次募投项目中，前述进口测试机计划采用供应商 A 的同类型国产测试机作为进口受限时的替代方案，进口探针台计划采用供应商 A 的同类型国产探针台等作为进口受限时的替代方案。

（二）存储芯片测试领域

本次募投项目是对公司现有存储芯片测试业务的扩产，报告期内存储芯片测试的收入分别为 5,377.47 万元、8,061.40 万元、8,882.35 万元及 6,827.22 万元，服务的存储芯片客户已有 10 余家。因此，公司在存储芯片测试业务的技术研发、客户开发、设备采购等方面具有丰富的经验，或者已经取得良好的成果，具体情况如下：

1、技术研发进展

公司已建立 NOR-Flash 等存储芯片成熟测试方案，掌握存储单元读写校验、BIST 内置自测试、可靠性、失效分析全套测试技术，可覆盖消费级、工业级存储芯片晶圆及成品测试；底层 ATE 测试框架、良率分析、量产管控体系与现有业务完全复用，技术成熟可直接用于规模化量产服务。

2、客户验证情况

公司已与普冉股份、兆易创新、东芯股份等国内多家存储芯片设计企业建立业务合作，完成供应商导入并实现量产测试交付。伴随国产存储产业发展，下游客户测试需求持续增长，存量客户需求持续释放，报告期内收入规模同比提升，募投扩充存储芯片测试产能，主要服务现有合作客户的业务增量需求。

3、设备采购储备

本次募投项目的存储芯片测试方向主要投向晶圆测试，需采购测试机和探针台 2 大类设备。其中，测试机拟采用供应商爱德万对应的主流测试机型，探针台拟采用供应商 SEMICS 的成熟探针台产品，上述设备均为公司已经熟练使用的设备，公司与主要设备供应商具有多年良好的合作关系，采购渠道通畅且稳定。

如前文所述，为了防范海外进口设备可能受限的风险，过去几年公司一直提前布局，已经为主要的进口设备均准备了完善的国产替代方案。在本次募投项目中，前述进口测试机计划采用厂商 J 的同类型国产测试机作为进口受限时的替代

方案，进口探针台计划采用供应商 A 的同类型国产探针台等作为进口受限时的替代方案。

（三）高端 CIS 芯片测试领域

本次募投项目是对公司现有 CIS 芯片测试领域的扩产和升级，报告期内 CIS 芯片测试的收入分别为 653.88 万元、1,123.34 万元、1,306.90 万元及 965.60 万元，服务的 CIS 芯片客户已有 7 家。

1、技术研发进展

发行人已形成“高清图像传感器芯片晶圆测试解决方案”等多项核心技术。高端 CIS 芯片 80%以上电性、可靠性测试技术，与 AI 算力芯片、存储芯片测试底层技术具备技术同源性，但 CIS 芯片成像测试存在差异化的特殊工程要求，需要配置专属“光源模块”，用于输出标准照度、标准色温的入射光，完成像素成像、噪点、坏点、色彩及图像缺陷检测，该硬件为逻辑、AI 算力、存储芯片测试所不需要；在量产场景下，为提升测试效率，还需实现“多-site 并行成像测试”，且必须配套大辐照面光源，严格保障各个测试站点光照条件均匀一致，对光源稳定性、系统协同控制提出更高工程挑战。

公司已完整掌握“CIS 芯片基础电性测试、MIPI 高速接口测试、标准化光源模块管控、多-site 并行成像测试、图像帧采集解析、图像缺陷判定、失效定位分析”等全套核心测试能力，可实现量产环节光源参数实时监测，有效规避光源漂移引发的测试误判、良率失真问题，保障多站点并行测试下光照条件一致性，具备成熟的测试程序开发、测试方案迭代、良率提升及客户失效分析服务能力。本次募投项目所涉及的高端 CIS 芯片测试系对公司已有的 CIS 芯片测试业务的升级，本次升级主要体现为在已验证的原有测试技术基础上，引入效率更高的新测试设备并用于下游客户迭代后的新产品，相关测试方法论、测试开发流程、良率优化方案及失效分析体系均可充分复用公司现有成熟技术、工程团队与业务积累，募投项目技术落地风险较低。

2、客户验证情况

公司目前已服务 7 家 CIS 芯片客户，本次募投项目高端 CIS 芯片测试产能，主要用于承接相关客户产品迭代升级后的测试需求。其中，客户 A、客户 I 为公

司两大战略客户，已明确对本次扩产予以支持。公司已完成高端光学传感器芯片测试方案开发，并与客户 I 开展测试业务对接，现已取得工程测试收入，前述工程验证旨在提前识别并排除后续可能对量产测试产生不利影响的各类潜在因素，为芯片量产测试落地奠定基础。公司该类业务工程验证周期通常为 1-2 个月，基于上述周期预估，预计 2026 年年底前即可进入芯片量产测试阶段。

3、设备采购储备

本次募投项目的高端 CIS 芯片测试方向主要投向晶圆测试，需采购测试机和探针台 2 大类设备。其中，测试机拟采用供应商爱德万对应的主流测试机型，探针台拟采用供应商 SEMICS 的成熟探针台产品，上述设备均为公司已经熟练使用的设备，公司与主要设备供应商具有多年良好的合作关系，采购渠道通畅且稳定。

如前文所述，为了防范海外进口设备可能受限的风险，过去几年公司一直提前布局，已经为主要的进口设备均准备了完善的国产替代方案。在本次募投项目中，前述进口测试机计划采用厂商 K 的同类型国产测试机作为进口受限时的替代方案，进口探针台计划采用供应商 A 的同类型国产探针台等作为进口受限时的替代方案。

综上所述，公司在本次三个募投产品方向上的技术研发、客户开发、设备采购等方面均具有丰富的经验并进行了充足的准备，并已经取得良好的成果，本次募投项目具备实施可行性。

三、结合募投产品的现有产能及规划产能情况、募投产品产能利用率、在手订单及意向订单、客户开发、前次募投项目产能爬坡进展及是否存在产能闲置等，说明新增产能消化的合理性，相关风险揭示是否充分

（一）结合募投产品的现有产能及规划产能情况、募投产品产能利用率、在手订单及意向订单、客户开发、前次募投项目产能爬坡进展及是否存在产能闲置等，说明新增产能消化的合理性

1、募投产品的现有产能及规划产能情况

截至 2026 年 6 月 30 日，按照募投项目投资领域，现有产能及新增产能情况如下表所示：

单位：万小时

芯片测试领域	现有产能	新增产能
AI 算力芯片	379.47	81.65
存储芯片	50.54	31.10
高端 CIS 芯片	-	11.66
合计	430.01	124.41

注：公司的机器设备是通用的，以上展示了具备测试三类芯片能力的机器设备的产能总和。本次募投项目的新增产能占公司现有产能的比例不高，本次扩产规模审慎合理，本次募投新增产能的消化具有合理性。

2、募投产品产能利用率情况

公司测试平台大部分具有通用性，除了可以测试 AI 算力芯片、存储芯片及高端 CIS 芯片三类芯片，也可以用于测试其他类型的芯片，因此无法单独计算某类产品的产能利用率。公司整体的产能利用率数据能够较好反应业务经营的实际情况，可以作为分析本次募投产品未来产能消化可行性的重要参考。报告期内，公司的产能利用率情况如下表所示：

单位：小时、%

期间	晶圆测试			芯片成品测试		
	理论产能总工时	测试总工时	产能利用率	理论产能总工时	测试总工时	产能利用率
2026 年 1-6 月	2,724,841.18	2,057,672.99	75.52	2,374,098.06	1,851,740.56	78.00
2025 年	4,313,130.91	3,072,837.79	71.24	3,290,746.56	2,568,166.06	78.04
2024 年	3,689,890.96	2,759,850.50	74.79	2,143,295.05	1,719,200.66	80.21
2023 年	2,969,991.20	1,976,416.16	66.55	1,369,544.27	775,708.95	56.64

公司属于服务性行业，为客户提供测试服务，测试周期较短，因此不存在产成品库存，产销率为 100%。报告期内，公司晶圆测试的产能利用率分别为 66.55%、74.79%、71.24%及 75.52%，芯片成品测试的产能利用率分别为 56.64%、80.21%、78.04%及 78.00%，公司产能利用率处于行业内较为优秀水平，在该产能利用率水平下，公司已经能够取得良好的利润水平。

最近三年一期，公司营业收入的增长率分别为 0.48%、46.21%、46.22%和 69.00%，呈现出加速增长的态势。报告期内，公司各年度产能利用率均未达到满产状态，并非公司产能存在闲置，而是公司在业务量高速增长背景下，同步进行了相匹配的新增产能建设，整体理论产能基数不断扩张，持续对公司产能利用

率造成稀释，若剔除新增设备产能扩张影响，上一年度存量理论产能总工时将不足以覆盖当年度测试总工时，如果公司暂停新增产能的建设，按照目前的业务增长速度，现有产能将在未来 6-12 个月内实现满产。

在国内 AI 芯片和存储芯片进入前所未有的景气大周期的背景下，公司预计营业收入在未来几年仍将保持高速增长，为了保障 2027 年及以后年度公司业绩增长所需要的产能，公司筹划了本次募投项目。考虑到设备采购和厂房建设的周期分别长达 6-24 个月以上，而公司现有产能利用率提升的空间已经有限，不足以支撑未来几年公司业务的增长，因此本次募投项目的实施具有必要性和紧迫性，本次募投项目产能的消化具有合理性。

3、在手订单及意向订单情况、长期市场需求、募投方向的下游需求及增速

（1）在手订单及意向订单情况

由于集成电路测试的测试周期较短，行业的通用模式是客户与公司签订测试服务的框架协议，该框架协议未明确具体的服务数量和金额，客户根据自身的排产安排每月分批次向公司发送具体的测试服务订单。公司在手订单仅反映公司最近一两周或者最近批次的生产情况，无法体现长期市场需求，无法用于分析本次募投项目的长期前景。

（2）长期市场需求情况

公司筹划本次募投项目，主要基于行业的长期市场需求。在全球半导体产业链重构与国内自主可控战略双轮驱动下，中国大陆集成电路测试市场正迎来高速增长期。据灼识咨询统计，2025 年中国大陆集成电路测试市场规模已达 432 亿元。展望未来，受益于高端算力芯片、高端 SoC 及汽车电子等复杂产品测试需求的集中释放，预计到 2030 年市场规模将突破 1,171 亿元，2025-2030 年间年均复合增长率达 22.1%。



数据来源：灼识咨询（长期服务于资本市场的专业行业咨询机构）

综上所述，本次募投项目的长期前景良好，下游需求将保持较高的增速，本次募投项目的产能消化具有合理性。

（3）募投方向的下游需求及增速

本次募投项目重点扩充 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片三个细分领域的产能。从底层驱动因素分析，三个方向均与人工智能的发展密切相关，其中 AI 算力芯片属于人工智能的“大脑”，存储芯片属于人工智能的“记忆”，高端 CIS 芯片属于人工智能的“眼睛”，三个方向均具有良好的发展前景，具体分析如下：

在 AI 算力芯片方向，根据弗若斯特沙利文的预测，中国的 AI 算力芯片市场规模将从 2024 年的 1,425.37 亿元激增至 13,367.92 亿元，2025 年至 2029 年期间年均复合增长率为 53.7%。从细分市场上看，GPU 的市场增长速度最快，其市场份额预计将从 2024 年的 69.9% 上升至 2029 年的 77.3%。

在存储芯片方向，由于人工智能产业的高速发展，导致存储芯片产能较大的供需缺口。根据头豹研究院预测，未来 4 年，我国存储芯片的市场规模将由 2025 年的 6,120 亿元增长到 2029 年的 9,860 亿元，复合增长率为 12.7%。

在 CIS 芯片方向，据弗若斯特沙利文预测，中国 CIS 芯片市场规模将从 2024 年的 386 亿元增长到 2029 年的 596 亿元。CIS 芯片不同细分品种的未来增速差

异较大，高端 CIS 芯片的增速较为突出，其中以自动驾驶为主要应用的车规级高端 CIS 芯片 2025 年至 2029 年的年度复合增速为 22.1%，以机器视觉为主要应用的工业成像、医疗成像、科学成像的高端 CIS 芯片 2025 年至 2029 年的年度复合增速为 22.5%、23.6%和 14.2%。

综上所述，本次募投方向的下游需求在未来几年均保持较高的增长速度，从而为本次募投项目的产能消化提供重要保障。

4、客户开发情况

单位：万元、%

类型	客户储备情况	2026 年 1-6 月		2025 年		2024 年		2023 年	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
AI 算力芯片	客户 A、客户 C、客户 B、客户 D、客户 E、客户 F、客户 G、客户 H 等	21,710.88	20.26	30,750.06	19.53	6,290.85	5.84	8,161.64	11.08
存储芯片	客户 A、客户 C、客户 B、普冉股份、兆易创新等	6,827.22	6.37	8,882.35	5.64	8,061.40	7.49	5,377.47	7.30
CIS 芯片	客户 A、客户 I 等	965.60	0.90	1,306.90	0.83	1,123.34	1.04	653.88	0.89
合计		29,503.69	27.53	40,939.31	26.00	15,475.59	14.37	14,192.99	19.27

在 AI 算力芯片、存储芯片方向，本次募投项目是对公司现有业务的扩产，报告期内上述业务发展情况良好，积累了一大批优质客户，为本次募投项目的产能消化提供了良好的客户基础。公司未来将继续开发新客户，为本次募投项目的实施提供更多的客户保障。

在高端 CIS 芯片方向，本次募投项目是对公司现有 CIS 芯片测试业务的升级，主要用于承接相关客户产品迭代升级后的测试需求。业务开展初期，计划主要满足客户 A、客户 I 两大战略客户的需求。2026 年 3 月，客户 A 首颗全栈自研的高端 CIS 芯片曝光，该芯片采用国产工艺，将进一步搅动高端市场格局。客户 A 作为国内芯片巨头，其新产品量产之后将会产生巨大的测试需求，公司作为其重要的测试服务供应商，已经收到其关于加快配套测试产能建设的业务需求。客户 I 作为另一战略客户，其构建了以“视觉+AI”为核心的多维产品矩阵，业务触角深入智能安防、视频对讲、智能车载及智能物联等多个高增长赛道。其中，其应用于智能驾驶的高端光学传感器芯片测试业务已经与公司对接，目前处于工程测试阶段，预计最快于 2026 年年底前即可进入量产测试阶段。本次募投项目在高端 CIS 芯片测试领域规划的年度收入为 5,097.17 万元，其设备投资占整个募投项目的比例约为 8%，规划的收入和投入并不大，依靠两大

战略客户的订单预计已经能够解决高端 CIS 芯片的产能消化问题。高端 CIS 芯片作为人工智能的“眼睛”，在自动驾驶、工业成像、医疗影像、科学成像等领域拥有良好的发展前景，公司未来将继续大力开发新客户，为本次募投项目的实施提供更多的客户保障。

5、前次募投项目产能爬坡进展及是否存在产能闲置等

单位：万元

前次募投项目	项目达到预定可使用状态日期	效益测算周期	营业收入实际发生额	年化后营业收入	募投项目规划的预期收入
无锡项目	2025 年 9 月	2025 年 9-12 月	8,398.17	25,194.51	16,621.20
		2026 年 1-6 月	12,515.66	25,031.32	24,931.80
南京项目	2024 年 12 月	2025 年度	25,528.27	25,528.27	20,855.23
		2026 年 1-6 月	14,673.23	29,346.46	28,965.60

由上表可见，前次募投无锡、南京项目在达到预定可使用状态后，实际实现的营业收入随产能爬坡逐步释放，实现的年化营业收入已经达到募投项目规划时预计收入水平，项目产能达到预期效果，不存在产能闲置情形。

6、结合前文内容，说明新增产能消化的合理性

如前文所述，从募投产品的现有产能及规划产能情况、公司产能利用率情况、长期市场需求情况、募投方向的下游需求及增速、客户开发情况、前次募投项目产能爬坡进展等方面分析，本次募投项目的新增产能消化具备合理性。

（二）相关风险揭示是否充分

发行人已在募集说明书“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”之“（四）募投项目实施风险”进行了风险提示，并在募集说明书“重大事项提示”中对“本次募投项目产能消化风险”进行了重大事项提示，风险揭示充分。

四、伟测科技西南总部及研发测试基地项目土地预计取得计划及时间，相关投资协议包含的效益指标是否存在无法达成的风险并补充风险提示

（一）项目土地预计取得计划

本项目土地取得分为规划咨询、施工技术预审、土地竞买三个阶段，依次完成并联审查、施工图及开工前置手续办理、参与土地竞买并签署《土地使用权出让合同》。截至本回复出具日，项目已签署投资合作协议，现阶段正在推进施工技术预审工作，后续将按计划推进土地相关各项工作。

（二）项目土地预计取得时间

结合项目当前实际进展及土地工作推进安排，预计 2026 年 11 月底前完成土地挂牌出让公告，2026 年 12 月底前取得土地使用权证书及建筑工程施工许可证。

依据成都市工业项目建设相关政策，带方案出让的工业项目可执行“拿地即可开工”，通过告知承诺、容缺办理，在获取土地使用权的同时办结施工许可等全部开工手续。本项目适用该政策，取得土地使用权后即可启动开工建设。

（三）相关投资协议包含的效益指标是否存在无法达成的风险

根据公司与成都高新技术产业开发区管理委员会已签订的《投资合作协议》，公司承诺经济效益指标为 2029 年—2033 年，项目公司研发投入（按会计核算口径，以《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》（财企〔2007〕194 号）规定为准）分别不低于人民币 1200 万元/年，5 年累计不低于人民币 1.5 亿元；2028 年—2033 年，项目固定资产投资总额累计不低于人民币 12 亿元；社会效益指标为自项目建成之日起 5 年内，项目公司员工人数分别达到 200 人、350 人、500 人、650 人、800 人，科技研发人员分别占 15%、20%、20%、20%、20%，本科及以上学历人员占比分别达到 40%、40%、40%、40%、40%；2030 年—2034 年，新授权知识产权（包括发明专利、集成电路布图、实用新型专利、软著）分别不低于 10 件、15 件、15 件、20 件、20 件。

1、关于经济效益指标

关于研发投入，公司 2023 年-2025 年研发费用占主营业务收入的比重平均为 13.71%，参照目前公司的研发费用占主营业务收入比重，西南项目设备投产后产生收入的五年内预估研发投入如下表所示：

单位：万元

项目	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
营业收入	8,854.27	18,261.94	28,222.99	29,883.17	30,989.95
研发投入	1,213.85	2,503.57	3,869.15	4,096.74	4,248.47
合计	15,931.78				

本次募投项目西南总部项目固定资产投资（含设备购置费、土地及基础设施建设费用）为 97,478.24 万元，公司后续将按照公司发展战略持续进行固定资产

投资，预期能够满足 2028 年—2033 年项目固定资产投资总额累计不低于人民币 12 亿元的指标要求。

2、关于社会效益指标

关于社会效益指标中项目公司员工人数及新授权知识产权部分，公司基于自身情况预期能够达到上述社会效益指标；截至 2026 年 6 月 30 日，公司现有员工结构中，研发人员占比为 18.33%，本科及以上学历人员占比为 49.24%，公司预期能够达到自项目建成之日起 5 年内科技研发人员分别占 15%、20%、20%、20%、20%，本科及以上学历人员占比为 40%以上的指标要求。

根据已签订的投资协议“四、其他条款”中的约定：“1、如乙方或项目公司非因不可抗力违反本协议承诺，且未在甲方要求的期限内对违约事项予以纠正的，甲方有权要求乙方采取补救措施，乙方未采取补救措施而造成重大违约、严重损害甲方利益的，甲方有权解除本协议。”

综上，基于公司现有人员基础、研发能力及业务发展规划，公司具备落实投资协议约定效益指标的实施基础，相关指标无法达成的风险较小。如出现指标未达标的情况，按照投资协议约定，公司可以在指定期限内采取补救整改措施；仅在发生非不可抗力导致的重大违约且未予纠正的情形，才会触发协议解除条款。

因此，相关投资协议包含的效益指标无法达成的风险较小，发行人已在《募集说明书》“第七节 本次募集资金运用”之“八、本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进程、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性”中披露了本次募投项目备案或审批情况；在《募集说明书》“第三节 风险因素”之“一、与发行人相关的风险”之“（四）募投项目实施风险”中披露了本次募投项目部分项目尚未取得土地使用权的情况；在《募集说明书》“重大事项提示”之“五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险”之“（七）部分募投项目尚未取得土地使用权的风险”中披露了本次募投项目部分项目尚未取得土地使用权的情况。

五、本次募投项目各项投资构成情况、测算过程及测算依据，相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目的对比情况，是否存在重大差异

(一) 本次募投项目各项投资构成情况、测算过程及测算依据

本次募投项目总体投资情况列示如下：

单位：万元

序号	名称	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	伟测科技上海总部基地项目	98,740.00	70,000.00
2	伟测科技西南总部及研发测试基地项目	100,000.00	80,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		248,740.00	200,000.00

各项目的具体投资构成及明细、各项投资构成的测算过程和测算依据列示如下：

1、伟测科技上海总部基地项目（上海项目）

上海项目的投资总额为 98,740.00 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元、%

序号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	募集资金金额占比
一	建设投资	97,740.00	70,000.00	100
1	土地及基础设施建设费用	44,370.95	25,800.00	36.86
2	设备购置费	52,394.62	44,200.00	63.14
3	预备费	974.43	-	-
二	铺底流动资金	1,000.00	-	-
合计		98,740.00	70,000.00	100

(1) 土地及基础设施建设费用

土地及基础设施建设包括相关土地使用权的出让金、厂房土建和机电工程等，具体投资构成、测算过程及测算依据如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	测算依据
1	土地	4,431.00	工业用地，已签订土地使用权出让合同，按合同实际金额
2	厂房土建	20,200.00	已签订合同，按合同实际金额
3	机电工程	16,320.00	已签订合同，按合同实际金额
4	装修	1,799.95	参考公司已实施无锡、南京同类项目装修标准

序号	项目	投资金额	测算依据
5	变电站	1,620.00	依据项目用电负荷需求，参考区域工业配套变电站市场造价水平测算
合计		44,370.95	

本项目土地及基础设施建设各项投资金额主要依据公司已签署的土地出让合同及厂房土建合同确定。截至本回复出具日，本项目上海项目主体工程已封顶，项目实际发生工程量与前期投资测算的建设规模基本匹配，未出现重大差异。

（2）设备购置费

本项目设备测算主要结合公司历史同类设备采购合同价格以及拟采购设备供应商报价综合确定，预计设备购置费 52,394.62 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额（万元）
测试机	70	41,458.97
探针台	35	4,039.20
分选机	35	6,896.45
合计	140	52,394.62

（3）预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。根据项目的实际情况，预估本项目预备费为 974.43 万元，占工程建设及设备购置费用的 0.99%。

（4）铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

2、伟测科技西南总部及研发测试基地项目（西南项目）

西南项目的投资总额为 100,000.00 万元。具体情况如下表所示：

单位：万元、%

序号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	募集资金金额占比
一	建设投资	99,000.00	80,000.00	100
1	土地及基础设施建设费用	36,139.69	28,000.00	35.00
2	设备购置费	61,338.55	52,000.00	65.00

序号	项目	投资金额	使用本次募集资金金额	募集资金金额占比
3	预备费	1,521.76	-	-
二	铺底流动资金	1,000.00	-	-
合计		100,000.00	80,000.00	100

(1) 土地及基础设施建设费用

土地及基础设施建设包括相关土地使用权的出让金、厂房土建和机电工程等，具体投资构成、测算过程及测算依据如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	测算依据
1	土地	1,080.00	参考成都高新区同区域工业用地公开出让成交价格测算，最终以土地出让合同为准
2	厂房土建	14,008.76	参考公司已实施上海、无锡、南京同类芯片测试洁净厂房造价水平，结合成都当地建筑市场造价、本项目建设规模及洁净厂房建设标准测算
3	机电工程	17,623.92	参考公司已建同类测试厂房机电配套指标，结合本项目工艺设备用电、洁净通风需求，对标成都地区同类型厂房机电造价测算
4	装修	1,427.00	参考公司已实施无锡、南京同类项目装修标准
5	变电站	2,000.00	依据项目用电负荷需求，参考区域工业配套变电站市场造价水平测算
合计		36,139.69	

发行人本次募投项目中土地及基础设施建设费用与公司前次可转债项目、利扬芯片可转债项目对比如下：

单位：平方米、万元、万元/平方米

序号	上海项目	西南项目	无锡项目	南京项目	利扬芯片可转债项目
新建建筑面积	77,263.00	90,379.10	61,020.00	55,373.00	25,572.00
土地建设费用	20,200.00	14,008.76	10,700.00	12,225.00	4,091.66
装修费用（含机电工程）	18,119.95	19,050.92	15,255.92	12,511.43	3,963.10
单位土地建设费用	0.26	0.16	0.18	0.22	0.16
单位建筑装修费用	0.23	0.21	0.25	0.23	0.15

对比各募投项目单位土地建设费用，上海项目 0.26 万元/m²、南京项目 0.22 万元/m²、无锡项目 0.18 万元/m²，成都项目 0.16 万元/m²，同行业利扬芯片可转债项目为 0.16 万元/m²。不同项目单位土地建设费用存在差异，主要受项目所在地土地取得成本、建材价格、人工成本等区域因素影响。成都项目单位土地建设

费用与同行业利扬芯片可转债项目基本持平，造价水平具备公允性。

对比各募投项目单位建筑装饰费用，本公司上海项目、南京项目 0.23 万元/m²，无锡项目 0.25 万元/m²，成都项目 0.21 万元/m²。成都项目造价略低于上海、无锡、南京项目，主要受益于成都本地人工、建材成本相对更低。同行业利扬芯片可转债项目单位建筑装饰费用 0.15 万元/m²，本公司项目单位建筑装饰费用整体处于 0.21-0.25 万元/m²区间，整体偏高，主要系本公司项目为高标准芯片测试洁净厂房，对洁净度、通风排风、温湿度控制、防微振及特种机电配套要求更高，而利扬芯片项目洁净厂房建设标准相对较低。因此，本次成都项目单位土地装修费用测算具备合理性。

（2）设备购置费

本项目设备测算主要结合公司历史同类设备采购合同价格以及拟采购设备供应商报价综合确定，预计设备购置费 61,338.55 万元，具体设备购置费情况如下：

设备类型	数量（台）	金额（万元）
测试机	90	47,191.39
探针台	45	5,227.39
分选机	45	8,919.77
合计	180	61,338.55

（3）预备费

预备费是针对在项目实施过程中可能发生的难以预料的支出而事先预留的费用。根据项目的实际情况，预估本项目预备费为 1,521.76 万元，占工程建设及设备购置费用的 1.54%。

（4）铺底流动资金

预计本项目投入铺底流动资金 1,000 万元，占项目总投资的比重约为 1%。

(二) 相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目的对比情况，是否存在重大差异

相关测算与公司前次募投项目及同行业公司可比项目对比情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	上海项目		西南项目		无锡项目		南京项目		利扬芯片可转债项目	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地及基础设施建设费用	44,370.95	44.94	36,139.69	36.14	29,138.92	29.51	28,150.38	31.28	8,306.95	6.32
设备购置费	52,394.62	53.06	61,338.55	61.34	67,038.00	67.89	60,305.38	67.01	113,236.50	86.10
预备费	974.43	0.99	1,521.76	1.52	1,563.08	1.58	544.24	0.60	6,077.17	4.62
铺底流动资金	1,000.00	1.01	1,000.00	1.00	1,000.00	1.01	1,000.00	1.11	3,899.00	2.96
合计	98,740.00	100.00	100,000.00	100.00	98,740.00	100.00	90,000.00	100.00	131,519.62	100.00

本次募投项目与前次募投项目均包含土地购置、场地平整、土建、厂房洁净装修及配套基础设施建设等完整建设内容。两次募投的四个项目实施地点各不相同，受土地取得成本、地方配套及当地工程造价水平影响，土地与基础设施建设费用占比略有区别，但各分项投资构成比例整体相近。

利扬芯片可转债募投项目依托其已有的自有土地新建厂房实施，土地取得、厂房土建投入未纳入募投测算，因此其土地及基础设施建设费用占比偏低，导致募集资金用于设备购置的比例较高。公司与同行业可比公司利扬芯片可转债项目的差异系项目土地厂房获取方式导致的募集资金投资细项占比不同，具备合理性。

综上，本次募投相关测算与公司前次募投项目土建投资占比略有区别，整体相近，与同行业可比公司利扬芯片可转债项目存在差异，但具备合理性。

六、本次募投项目效益测算中测试单价、时长等指标选取的主要依据，与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异，新增折旧摊销对公司未来业绩的影响，本次效益测算是否谨慎、合理

（一）测试单价的选取依据及与公司现有产品及可比公司同类产品是否存在重大差异

1、测试单价的选取依据

在本次募投效益测算中，各测试机的每小时测试单价的选取，均参考了公司同型号设备的实际报价。

2、测试单价的选取依据及与公司现有产品是否存在重大差异

如上文所述，在本次募投效益测算中，各测试机的每小时测试单价的选取，均参考了公司同型号同配置设备的实际报价，与公司现有产品不存在重大差异。

3、测试单价与可比公司同类产品是否存在重大差异

各测试机的每小时测试单价属于测试企业的高等级商业机密，公开渠道无法获取与本项目测算口径匹配的测试单价数据，故无法直接与可比公司同类产品单价进行同口径对比。

（二）测试时长的选取依据及与公司现有情况及可比公司情况对比

1、测试时长的选取依据

公司系测试服务供应商，按测试时长收费，测试时长相当于公司的可用产能。公司本次募投效益测算使用的测试时长计算公式为：测试时长=24 小时*360 天*90%。其中，24 小时源于公司测试机全天运行，360 天是为简化计算选取的全年运行天数，考虑到测试平台在运转过程中存在检修、维护等因素，故测试时长以全年时长的 90%计算。

2、测试时长与公司现有产品是否存在重大差异

本次募投项目效益测算所使用的测试时长公式与公司 IPO 及前次可转债募投效益测算所使用的测试时长公式一致。

3、测试时长与可比公司同类产品是否存在重大差异

公司及可比公司用于计算测试时长的公式如下：

公司名称	测试时长计算公式
利扬芯片	Σ 各月末测试平台数量/12*年度运转工作天数*24 小时*80%
朗迅科技	Σ （各月测试平台数量*24 小时*当月天数）*90%-研发用时
伟测科技	Σ （各月测试平台数量*24 小时*当月天数）*90%

如上表所述，公司测试时长的计算方法与同行业可比公司基本相同，主要区别在于个别参数的设置上存在差异，具体分析如下：①利扬芯片运行效率的取值为 80%，而公司为 90%，主要因为公司产品档次更高，单位产品测试时间更长，中途切换的次数更少，能够实现更高的作业效率，因此根据历史的实际运行情况将该指标设置为 90%，该取值与另一可比公司朗迅科技一致。②朗迅科技的计算公式存在“扣减研发用时”的项目，而公司不存在该项目，主要因为公司拥有独立的研发设备，与生产设备不存在混用的情形，因此不需要扣减研发用时。

（三）新增折旧摊销对公司未来业绩的影响

本次募投项目完全达产后，相关折旧、摊销等费用对财务状况和经营业绩的影响情况如下：

单位：万元

项目	上海项目	西南项目
每年新增折旧摊销总额	7,458.01	7,940.84
每年新增营业收入	28,551.53	31,543.34
折旧摊销占预计营业收入比重	26.12%	25.17%

本次上海项目与西南项目完全达产后，预计每年新增折旧摊销占本次募投项目新增营业收入的比重分别为 26.12%和 25.17%。通过本次募投项目的实施，公司将扩张集成电路测试产能，尤其是 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试产能，提升测试方案开发能力，增强核心技术水平和产品竞争力，促进主营业务发展与科技创新水平持续提升。未来公司将持续加大研发投入，重点针对 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片的测试等方向，着重突破各类芯片的测试难点，为公司持续发展注入新动能。公司募投项目前景良好，新增产能预计能够较好地消化，有望进一步提升公司的持续盈利能力。

（四）本次效益测算是否谨慎、合理

本次募投效益测算预测期内的完全达产后毛利率如下：

募投项目名称	上海项目	西南项目	利扬芯片可转债募投项目
预测达产毛利率	50.82%	50.32%	63.58%

公司最近三年高端测试平台毛利率情况如下：

盈利指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
公司高端测试机型毛利率	47.74%	47.08%	48.14%

与公司的历史情况相比，本次两个募投项目的收入基本来自高端测试平台，其收入占比超过 90%，项目毛利率在 50%左右，略高于公司高端测试业务过去三年约 48%的平均水平，主要因为本次募投项目的 AI 算力芯片测试业务的占比更高，并且高端测试平台的档次亦高于公司现有水平，因此具有合理性。

与同行业可比公司相比，本次两个项目的毛利率低于利扬芯片可转债募投项目水平，因此是谨慎和合理的。

本次募投效益测算的内部收益率与可比公司对比情况如下：

项目名称	内部收益率
利扬芯片 2023 年可转债项目	18.94%
公司本次募投项目-上海项目	16.03%
公司本次募投项目-西南项目	16.17%

如上表所示，本次上海项目及西南项目的内部收益率分别为 16.03%和 16.17%，低于同行业可比公司利扬芯片可转债项目，效益测算谨慎。

综上所述，本次募投项目效益测算的单价、测试时长等主要指标的选取是合理的，效益测算的结果是谨慎的。

七、结合公司货币资金余额、资产负债结构等，说明本次融资的必要性、融资规模的合理性

综合考虑公司使用受限的货币资金余额、未来三年预计经营活动现金流量净额，最低现金保有量、未来三年预计新增最低现金保有量、有息负债等项目，上市公司整体资金缺口预计为 33.65 亿元，本次募集资金与未来三年资金需求相匹配，本次募集资金总额 20 亿元未超过公司总体资金缺口，融资必要、规模合理。

具体测算过程如下：

单位：万元

序号	科目	计算公式	金额
1	2025 年末货币资金及交易性金融资产余额	①	41,305.05
2	其中：报告期末使用受限货币资金	②	28.62
3	可自由支配资金余额	③=①-②	41,276.43
4	未来期间经营活动产生的现金流量净额	④	366,243.79
5	最低现金保有量需求	⑤	43,421.94
6	未来期间新增最低现金保有量需求	⑥	51,976.06
7	未来期间预计现金分红	⑦	65,869.63
8	未来期间偿还有息债务利息	⑧	17,766.53
9	未来资本性项目支出需求	⑨	565,031.48
10	未来资金需求合计	⑩=⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	744,065.63
11	总体资金缺口	⑪=⑩-④-③	336,545.41

（一）可自由支配资金

截至 2025 年末，公司可自由支配的资金情况如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
货币资金及交易性金融资产	①	41,305.05
其中：受限货币资金	②	28.62
可自由支配资金	③=①-②	41,276.43

（二）未来期间经营活动产生的现金流量净额

以报告期内财务数据为基础，综合考虑历史上销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金等分别与营业收入、营业成本的关系，采用直接法对未来期间经营性现金流入净额进行测算。

1、营业收入与营业总成本

最近三年，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元和 157,464.24 万元，年复合增长率达到 46.22%。基于谨慎性原则，假设公司未来三年的营业收入按 30%增长。

单位：万元

项目	2026 年度	2027 年度	2028 年度
营业收入	204,703.51	266,114.57	345,948.94
营业总成本	172,128.71	223,767.33	290,897.53

2、经营活动现金流入预计

未来三年的经营活动现金流入基于公司 2025 年度经营活动现金流入占营业收入比例测算：2025 年度，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例为 93.56%；公司收到其他与经营活动有关的现金占营业收入的比例为 2.79%。

3、经营活动现金流出预计

未来三年的经营活动现金流出基于公司 2025 年度经营活动现金流出占营业总成本的比例测算：2025 年度，公司购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比例为 24.42%；公司支付给职工及为职工支付的现金占营业成本的比例为 31.37%；公司支付的各项税费占营业成本的比例为 2.34%；公司支付其他与经营活动有关的现金占营业成本的比例为 3.12%。

基于以上假设及预估的财务数据测算的未来三年公司经营活动现金流入净额合计约为 366,243.79 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年度	2027 年度	2028 年度
营业收入	204,703.51	266,114.57	345,948.94
营业总成本	172,128.71	223,767.33	290,897.53
销售商品、提供劳务收到的现金	191,527.92	248,986.30	323,682.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,715.71	7,430.43	9,659.56
经营活动现金流入小计	197,243.64	256,416.73	333,341.75
购买商品、接受劳务支付的现金	42,039.17	54,650.92	71,046.19
支付给职工及为职工支付的现金	54,000.26	70,200.34	91,260.45
支付的各项税费	4,036.00	5,246.80	6,820.85
支付其他与经营活动有关的现金	5,377.78	6,991.11	9,088.45
经营活动现金流出小计	105,453.21	137,089.18	178,215.93
经营活动产生的现金流量净额	91,790.42	119,327.55	155,125.82
2026 年至 2028 年经营活动现金流量净额合计	366,243.79		

（三）最低现金保有量

最低现金保有量系公司为维持其日常营运所需要的最低货币资金金额，以应对客户回款不及时的情况，及支付供应商货款、员工薪酬、税费等短期付现成本。为保证公司平稳运行，确保在客户未及时回款的情况下公司基本性的现金支出需要能够得到满足。最近三年，公司可自由支配资金余额除以各期月均经营活动现金支出分别为 12.25 个月、7.62 个月和 6.11 个月，平均为 8.66 个月。具体如下：

单位：万元

项目	计算公式	2025 年度 /2025 年末	2024 年度 /2024 年末	2023 年度 /2023 年末
货币资金及交易性金融资产	①	41,305.05	41,401.94	36,212.75
其中：受限货币资金	②	28.62	5,146.17	-
可自由支配资金	③=①-②	41,276.43	36,255.78	36,212.75
经营活动现金流出小计	④	81,117.86	57,106.51	35,463.38
月均经营活动现金支出	⑤=④/12	6,759.82	4,758.88	2,955.28
覆盖月份数（月）	⑥=③/⑤	6.11	7.62	12.25
平均覆盖月份（月）		8.66		

根据公司目前可自由支配的资金覆盖的情况，结合公司经营管理经验、现金收支以及未来三年公司经营情况等，基于谨慎性原则，假设最低现金保有量为公司 9 个月的经营活动现金流出资金，最低现金保有量需求为 43,421.94 万元。具体测算如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
2023 年至 2025 年经营活动现金流出累计金额	①	173,687.74
2023 年至 2025 年月份数（月）	②	36
2023 年至 2025 年月均经营活动现金流出	③=①/②	4,824.66
最低现金保有量需求	④=③*9	43,421.94

（四）新增最低现金保有量

最低现金保有量需求与公司经营规模相关，假设最低现金保有量的增速与营业收入增速一致。结合目前市场需求情况与未来发展趋势，基于谨慎性原则，假设公司未来三年的营业收入按 30.00%的增长率保持增长，公司未来三年新增最低现金保有量需求为 51,976.06 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
最低现金保有量需求	①	43,421.94
未来三年末最低现金保有量	②=①×(1+30.00%) ³	95,397.99
未来三年新增最低现金保有量需求	③=②-①	51,976.06

(五) 未来期间预计分红

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润	30,319.86	12,822.88	11,799.63
现金分红金额（含税）	9,244.86	3,881.43	3,627.97

最近三年，公司累计现金分红金额为 16,754.26 万元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润复合增长率为 60.30%。基于谨慎性原则，假设公司未来三年现金分红按照 50.00% 增长，预计公司未来三年分红合计 65,869.63 万元。

(六) 未来期间偿还有息债务利息

截至 2025 年末，公司短期借款余额 46,229.90 万元，一年内到期的长期借款余额 30,413.38 万元，长期借款余额 197,529.05 万元。截至 2025 年末，公司短期借款平均借款利率为 2.18%，长期借款平均借款利率为 2.69%，预计未来三年偿还有息债务利息 17,766.53 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	短期借款	一年内到期的长期借款	长期借款
期末余额	46,229.90	30,413.38	197,529.05
平均借款利率	2.18%	2.69%	2.69%
未来三年利息	1,007.81	818.12	15,940.59
未来三年利息合计	17,766.53		

注：未来三年利息合计=短期借款期末余额*平均借款利率+一年内到期的长期借款期末余额*平均借款利率+长期借款期末余额*平均借款利率*3

(七) 未来资本性项目支出

截至本回复出具日，公司已审议的拟投资项目如下：

项目名称	投资金额（亿元）	审议情况
伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项	13.00	已经第二届董事会第十

目（二期）		四次会议审议
车规级控制器元器件测试建设项目	4.50	已经总经理办公会审议
车载激光雷达射频元器件检测设备更新项目	3.50	已经总经理办公会审议
伟测科技上海总部基地项目	9.87	已经第二届董事会第二十九次会议审议
伟测科技西南总部及研发测试基地项目	10.00	已经第二届董事会第二十九次会议审议
合计	40.87	/

上述项目为公司未来三年的主要资本性支出项目，拟投资金额合计 40.87 亿元。鉴于第三方集成电路测试行业属于典型的资本密集型行业，受下游客户需求、技术快速迭代及公司自身扩产等多重因素驱动，公司需持续进行大规模的固定资产投入。2023-2025 年，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金累计达 56.50 亿元，充分印证了公司持续高强度的投入特征。结合上述已审议项目的资金需求、行业特性以及潜在产能储备规划，并参考报告期内的实际投入规模，公司审慎预计未来三年累计资本性投入为 565,031.48 万元。具体情况如下：

单位：万元

资本性支出	2025 年度	2024 年度	2023 年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,598.10	148,277.24	122,156.14
最近三年累计投入金额	565,031.48		
未来三年预计投入金额	565,031.48		

综上，综合考虑公司货币资金余额、资产负债结构等项目，公司未来三年整体资金缺口预计为 33.65 亿元，本次募集资金规模与未来三年资金需求相匹配，本次融资具备必要性、合理性。

八、中介机构核查情况

（一）核查程序

针对上述事项，保荐机构执行了如下核查程序：

1、查阅发行人报告期内的定期报告、前次募集资金的可行性研究报告、前次募集资金使用情况鉴证报告等资料，并对发行人管理层进行访谈，了解本次募集资金投向及具体规划、本次募投项目与公司主营业务及前次募投项目的区别与联系；

2、查阅发行人本次募投项目的预案、可行性分析报告、相关产业政策、行

业研究报告等，以及可比公司现有产能及扩产情况，分析本次募投项目的必要性、合理性及紧迫性；

3、查阅发行人报告期内的产能利用率明细表，了解报告期内公司产能利用率变动情况，发行人本次募投项目中已有产能及新增产能情况，分析本次募投项目产能规模的合理性；

4、访谈发行人管理层，了解发行人“AI 芯片测试”、“存储芯片测试”以及“高端 CIS 芯片测试”项目研发的技术储备、客户验证情况、拟采购设备的供应稳定性等，了解公司实施本次募投项目在技术、客户及设备方面的相关储备；

5、查阅相关行业研究报告，了解本次募投项目投资领域的基本情况、下游领域市场空间、产品竞争格局及竞争优势，分析新增产能消化的合理性；

6、查阅了公司与成都市高新区管理委员会签订的《投资合作协议》及相关补充协议、《成都市住房和城乡建设局等 4 部门关于进一步优化产业园区工业项目开工建设和竣工验收工作的通知》【成住建规〔2025〕1 号】以及“拿地即开工”审批服务流程图，访谈公司管理层，了解伟测科技西南总部及研发测试基地项目土地取得计划、时间安排及目前进展，并分析相关投资协议包含的效益指标是否存在无法达成的风险；

7、获取本次募投项目的可行性研究报告，了解本次募投项目的具体投资构成、经济效益以及相关测算假设和测算过程情况等；计算新增折旧摊销对公司未来业绩的影响；

8、查阅同行业上市公司公开披露资料，同行业上市公司相关项目投资构成及测算过程，经济效益及测算过程等。

（二）核查结论

经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片测试市场需求旺盛，发展趋势良好，竞争对手均积极扩产，本次募投具备必要性；本次募投项目与前次募投项目的投向在 AI 算力芯片领域存在较大重合，因此在测试类型、目标客户、应用领域等方面存在较大重合；本次募投项目不存在新产品。发行人主营业

务为第三方集成电路测试服务，本次募投涉及的 AI 算力芯片测试、存储芯片测试及高端 CIS 芯片测试均属于公司现有集成电路测试服务业务，仅为针对不同芯片产品的测试服务细分。本次募集资金投向均用于现有业务的扩产或升级，不存在用于拓展新业务、新产品的情形，符合募集资金应投向主业的要求。

2、本次募投项目围绕发行人主营业务集成电路第三方测试服务开展，重点扩充 AI 算力芯片、存储芯片、高端 CIS 芯片测试产能。公司在本次三个募投产品方向上的技术研发、客户开发、设备采购等方面均具有丰富的经验并进行了充足的准备，并已经取得良好的成果，本次募投项目具备实施可行性；

3、本次募投项目的产能消化具备客户基础，公司前次募投项目投产后营业收入已达到募投效益测算标准，项目产能按计划爬坡，不存在产能闲置的情况，新增产能消化具备合理性；

4、结合伟测科技西南总部及研发测试基地项目土地相关工作推进计划及当前实际进展，预计 2026 年 11 月底前完成土地挂牌出让公告，2026 年 12 月底前取得土地使用权证书及建筑工程施工许可。公司与成都市高新区管委会签订的相关投资协议包含的效益指标无法达成的风险较小，发行人已在《募集说明书》等文件中对募投用地的相关风险进行了充分披露；

5、本次募投相关测算与公司前次募投项目土建投资占比略有区别，整体相近，与同行业可比公司利扬芯片可转债项目存在差异，但具备合理性；

6、在本次募投效益测算中，各测试机的每小时测试单价的选取，均参考了公司同型号同配置设备的实际报价，与公司现有产品不存在重大差异；各测试机的每小时测试单价属于测试企业的高等级商业机密，公开渠道无法获取与本项目测算口径匹配的测试单价数据，故无法直接与可比公司同类产品单价进行同口径对比。公司本次募投效益测算使用的测试时长与 IPO 及前次可转债募投效益测算相同，测试时长的构成符合行业现状及公司实际情况，本次募投效益测算是谨慎和合理的；

7、公司本次融资规模符合公司现有货币资金用途及资产负债情况，本次融资规模未超过公司总体资金缺口，融资规模具有合理性。

问题 2 关于业务与经营情况

根据申报材料：(1)2023 年至 2026 年一季度，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 48,997.56 万元，净利润分别为 11,799.63 万元、12,822.88 万元、30,319.86 万元和 7,085.80 万元，主营业务毛利率分别为 38.32%、37.48%、39.01%和 33.51%；(2) 2023 年至 2026 年第一季度，公司应收账款账面价值分别为 30,834.29 万元、35,333.86 万元、52,748.12 万元和 54,043.83 万元；(3) 2023 年至 2026 年一季度，公司固定资产分别为 196,406.21 万元、288,739.09 万元、412,883.37 万元和 499,379.86 万元，在建工程分别为 51,413.82 万元、66,982.48 万元、158,511.14 万元和 157,644.54 万元。

请发行人说明：(1) 结合公司测试服务单价、工时、产能利用率等情况，说明 2023 年至 2026 年第一季度业绩增长的主要原因，与同行业可比公司是否存在重大差异，并说明 2026 年第一季度毛利率下滑的主要原因；(2) 应收账款增长的原因及合理性，并结合应收账款账龄结构、主要客户、期后回款等，说明坏账准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异；(3) 报告期内公司在建工程主要项目的转固时点，是否存在应转固未及时转固的情形，并说明在建工程转固后新增产能的消化情况，是否存在固定资产闲置及减值风险；(4) 截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资。

请保荐机构和申报会计师进行核查并发表明确意见。

【回复】

一、结合公司测试服务单价、工时、产能利用率等情况，说明 2023 年至 2026 年第一季度业绩增长的主要原因，与同行业可比公司是否存在重大差异，并说明 2026 年第一季度毛利率下滑的主要原因

(一) 结合公司测试服务单价、工时、产能利用率等情况，说明 2023 年至 2026 年第一季度业绩增长的主要原因

报告期内，公司测试服务单价、工时和产能利用率情况如下：

单位：元/小时、万小时、%

期间	晶圆测试单价	芯片成品测试单价	测试总工时	产能利用率
2026 年 1-6 月	240.64	273.16	390.94	76.67
2025 年	278.66	230.95	564.10	74.19
2024 年	221.54	209.92	447.91	76.79
2023 年	223.89	277.33	275.21	63.27

报告期内，公司不同测试服务类型的工时和产能利用率情况如下：

单位：万小时、%

期间	晶圆测试		芯片成品测试	
	测试总工时	产能利用率	测试总工时	产能利用率
2026 年 1-6 月	205.77	75.52	185.17	78.00
2025 年	307.28	71.24	256.82	78.04
2024 年	275.99	74.79	171.92	80.21
2023 年	197.64	66.55	77.57	56.64

2023 年至 2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元及 107,185.98 万元，分别同比增长 0.48%、46.21%、46.22% 及 69.00%，业绩保持高速增长趋势，主要原因分析如下：

2024 年下半年起，集成电路行业进入上游库存去化、下游需求复苏阶段，大量国产高端芯片和车规级芯片进入量产阶段，市场对高端芯片和高可靠性芯片测试需求明显增加，公司收入结构以高端测试为主，因此业绩复苏以及测试总工时和产能利用率的恢复较为明显，公司测试总工时由 2023 年度的 275.21 万小时上升至 2024 年度的 447.91 万小时，增幅为 62.75%，产能利用率从 63.27% 上升至 76.79%。但由于上一轮行业周期下行带来的单价下降因素尚未完全消除，公司 2024 年度测试单价较 2023 年度仍呈下降趋势。

2025 年，受益于 AI、智驾等新兴领域的快速发展，集成电路行业增长强劲，高端测试需求爆发，公司产品结构持续优化，进入价量齐升的阶段：晶圆测试单价由 221.54 元/小时上升至 278.66 元/小时，增幅为 25.78%，晶圆测试总工时由 275.99 万小时上升至 307.28 万小时，增幅为 11.34%。芯片成品测试单价由 209.92 元/小时上升至 230.95 元/小时，增幅较缓，芯片成品测试总工时由 171.92 万小时上升至 256.82 万小时，增幅为 49.38%，增长显著。同时，公司前次可转债募投项目及自筹资金扩产项目于 2025 年陆续投产，新增产能处于爬坡阶段，故 2025

年度公司产能利用率较 2024 年度略有下降，但仍维持在较高水平。

2026 年 1-6 月，AI 推理需求爆发、智能驾驶渗透、大容量存储需求扩张进一步推动公司高端测试需求增长。芯片成品测试单价较上年度增长 42.21 元/小时，增幅为 18.28%，主要系芯片成品测试中高端测试收入占比较上年度提升 8.13 个百分点至 66.26%，且高端芯片成品测试通常需配套三温测试、老化测试和系统级测试，收费标准较高所致。公司晶圆测试单价较上年度下降 38.02 元/小时，降幅为 13.64%，主要系公司应部分客户要求，优化测试流程导致该部分客户测试单价相应降低，加之部分客户需求旺盛，公司给予一定价格优惠所致。同时，公司测试总工时和产能利用率仍维持较高水平，带动公司业绩持续高速增长。

综上，报告期内，公司晶圆测试单价呈波动上升趋势，芯片成品测试单价呈先下降后回升趋势，测试总工时逐年稳定上升且产能利用率均维持在较高水平，上述因素共同驱动公司业绩高速增长。

（二）与同行业可比公司是否存在重大差异

报告期内，公司与同行业可比公司的营业收入及同比增长率情况如下：

单位：万元、%							
公司名称	2026 年 1-6 月	增长率	2025 年	增长率	2024 年	增长率	2023 年
利扬芯片	35,632.85	25.45	61,839.44	26.69	48,812.56	-2.97	50,308.45
华岭股份	15,930.14	1.05	31,625.82	14.47	27,627.56	-12.43	31,548.96
朗迅科技	未披露	未披露	206,430.25	89.86	108,728.04	103.03	53,553.63
本公司	107,185.98	69.00	157,464.24	46.22	107,686.99	46.21	73,652.48

报告期内，公司营业收入同比增长率保持较高水平。2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司与同行业可比公司的收入变动均呈上升趋势，2024 年度及 2025 年度，朗迅科技营收增长率显著高于公司，而利扬芯片和华岭股份 2024 年度营业收入呈现下降趋势，主要原因分析如下：

1、从测试单价的角度分析，报告期内，公司与可比公司的测试单价情况如下：

公司名称	产品	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
利扬芯片	晶圆测试（元/片）	未披露	未披露	316.10	405.73

公司名称	产品	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
	芯片成品测试（元/千颗）	未披露	未披露	144.61	195.85
华岭股份	晶圆测试（元/片）	未披露	未披露	305.42	413.01
	芯片成品测试（元/千颗）	未披露	未披露	322.10	179.17
朗迅科技	晶圆测试（元/小时）	未披露	464.15	432.50	412.16
	芯片成品测试（元/小时）	未披露	758.88	635.77	514.30
本公司	晶圆测试（元/小时）	240.64	278.66	221.54	223.89
	芯片成品测试（元/小时）	273.16	230.95	209.92	277.33

注：朗迅科技测试单价系通过当期营业收入除以测试总工时自行计算得出。

2024 年，公司晶圆测试和芯片成品测试单价较上年度呈现下降趋势，与可比公司利扬芯片的趋势保持一致，主要系上一轮行业周期下行带来的单价下降因素尚未完全消除所致，但由于公司 2024 年度测试总工时增幅较大，营业收入规模仍保持高速增长的趋势。华岭股份芯片成品测试单价较上年度增幅较高，主要原因是其 2024 年重点拓展了车规级、AI/FPGA、高可靠性芯片的测试业务，这类订单对测试条件（如三温测试、可靠性验证）要求高，单颗测试费远高于消费类芯片；但由于 2024 年度消费类芯片测试需求低迷，同时 IDM 厂商转向自建测试产线，导致其晶圆测试外包订单大幅流失，晶圆测试单价和整体营收仍呈现下降趋势。2024 年，朗迅科技晶圆测试单价及芯片成品测试单价均有所上升，主要系其 2024 年度战略层面主动放弃毛利率较低的低端消费电子芯片散单，聚焦算力、车载、工业等高毛利客户，订单结构优化直接拉高平均单价，与其较高的营收增长率相匹配。

2025 年，可比公司利扬芯片和华岭股份未披露测试单价数据，故仅比较分析朗迅科技和公司的变动差异。朗迅科技和公司的测试单价均呈现上升趋势，与营收增长趋势保持一致，其中朗迅科技的芯片成品测试单价增幅较大，主要系当年手机 SoC 芯片及 UFS 芯片等测试规模快速增长，相关芯片测试难度和测试单价较高所致。

2、从测试工时和产能利用率的角度分析，由于利扬芯片和华岭股份未披露相关数据，因此仅与朗迅科技进行比较分析。报告期内，公司与朗迅科技晶圆测试的测试工时及产能利用率情况如下：

期间	朗迅科技			伟测科技		
	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率	产能利 用率	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率	产能利 用率
2026 年 1-6 月	未披露	未披露	未披露	206	34%（年化）	76%
2025 年	133	125%	88%	307	11%	71%
2024 年	59	84%	78%	276	39%	75%
2023 年	32	未披露	83%	198	10%	67%

从晶圆测试的角度分析，2023 年至 2025 年，朗迅科技的产能利用率均维持较高水平，且测试总工时增长率于 2024 年及 2025 年分别达到 84%和 125%，增幅较大，与其高速营收增长相匹配。公司晶圆测试总工时基数较朗迅科技整体偏高，且公司处于持续扩产阶段，导致产能利用率和增长率相对较低，但仍保持稳定增长的趋势，与营收增长相匹配。

报告期内，公司与朗迅科技芯片成品测试的测试工时及产能利用率情况如下：

期间	朗迅科技			伟测科技		
	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率	产能利 用率	测试总工时 (万小时)	测试总工时 增长率	产能利 用率
2026 年 1-6 月	未披露	未披露	未披露	185	44%（年化）	78%
2025 年	129	54%	76%	257	49%	78%
2024 年	84	79%	73%	172	121%	80%
2023 年	47	未披露	66%	78	-20%	57%

从芯片成品测试的角度分析，公司 2024 年和 2025 年的产能利用率均高于朗迅科技，仅 2023 年较低，且公司 2024 年和 2025 年的测试总工时增长率较为显著，与朗迅科技的增长趋势及公司自身营收增长保持一致。

综上，2024 年度利扬芯片、华岭股份受行业周期下行影响，营业收入有所下降，公司及朗迅科技仍保持增长；2025 年以来公司与同行业可比公司营业收入均呈增长趋势，业绩变动方向一致，增速差异主要系各公司产品结构、客户结构及收入基数不同所致，与各自测试单价、测试工时及产能利用率的变化相匹配，具有合理性，公司与同行业可比公司不存在重大差异。

（三）说明 2026 年第一季度毛利率下滑的主要原因

报告期内，公司毛利率情况如下：

财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
主营业务毛利率	32.87%	39.01%	37.48%	38.32%
其他业务毛利率	45.98%	45.96%	33.27%	47.81%
综合毛利率	33.59%	39.37%	37.11%	38.96%

2026 年 1-6 月，公司综合毛利率为 33.59%，较上年度下降 5.78 个百分点；主营业务毛利率为 32.87%，较上年度下降 6.14 个百分点。公司综合毛利率与主营业务毛利率变动趋势一致，具体分析如下：

1、行业季节性因素，上半年综合毛利率历来低于全年水平

报告期内，公司上半年综合毛利率和全年综合毛利率情况如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
上半年综合毛利率	33.59%	36.43%	35.28%	41.35%
全年综合毛利率	/	39.37%	37.11%	38.96%

2024 年度、2025 年度，公司上半年综合毛利率均低于全年综合毛利率，该趋势系行业季节性因素所致，属于行业常规经营特征。2023 年度属于特殊情形，当年集成电路测试行业处于下行周期，下半年行业景气度持续走弱，使得全年综合毛利率低于上半年水平，不具代表性。

2、持续扩产，新增产能爬坡，导致刚性固定成本支出较高

报告期内，公司产能利用率分别为 63.27%、76.79%、74.19%和 76.67%。2025 年度，公司前次可转债募投项目及自筹资金扩产项目陆续投产，新增产能尚未完全释放，处于爬坡阶段。2026 年 1-6 月，公司持续扩大集成电路测试产能，平均设备数量由 2025 年上半年的 861 台增长至 2026 年上半年的 1,244 台，增幅为 44.48%，相关折旧、能源费用等刚性固定成本已开始计入，导致设备折旧及租赁费用、能源费用较上年同期分别增长 10,764.65 万元和 2,111.72 万元，增幅分别为 57.06%和 51.29%，进而推动 2026 年上半年公司主营业务成本增长较大。

综上，报告期内，公司综合毛利率分别为 38.96%、37.11%、39.37%和 33.59%，其中 2026 年 1-6 月综合毛利率下降较为明显，主要系行业季节性因素及新增产能爬坡影响所致。

二、应收账款增长的原因及合理性，并结合应收账款账龄结构、主要客户、期后回款等，说明坏账准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异

（一）应收账款增长的原因及合理性

报告期各期末，公司应收账款及营业收入情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月 /2026.6.30	2025 年度 /2025.12.31	2024 年度 /2024.12.31	2023 年度 /2023.12.31
应收账款账面余额	61,010.41	55,527.99	37,205.29	32,479.79
应收账款坏账准备	3,054.50	2,779.88	1,871.42	1,645.50
应收账款账面价值	57,955.91	52,748.12	35,333.86	30,834.29
增长率	9.87%	49.28%	14.59%	/
营业收入	107,185.98	157,464.24	107,686.99	73,652.48

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 30,834.29 万元、35,333.86 万元、52,748.12 万元和 57,955.91 万元，整体呈上涨趋势。报告期各期末，公司应收账款增加主要系 IPO、前次可转债募投项目及自筹资金项目陆续投产，带动营业收入持续增长。报告期内，公司应收账款与营业收入变动趋势一致，具备商业合理性。

综上，公司报告期各期末应收账款的增长具备合理性。

（二）结合应收账款账龄结构、主要客户、期后回款等，说明坏账准备计提是否充分，与同行业可比公司是否存在重大差异

1、应收账款账龄结构

报告期各期末，公司应收账款账龄结构如下：

单位：万元，%

账龄	2026.6.30			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	60,930.84	99.87	3,046.54	57,884.29
1-2 年	79.58	0.13	7.96	71.62
2-3 年	-	-	-	-
合计	61,010.41	100.00	3,054.50	57,955.91
账龄	2025.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值

1 年以内	55,458.46	99.87	2,772.92	52,685.54
1-2 年	69.53	0.13	6.95	62.58
2-3 年	-	-	-	-
合计	55,527.99	100.00	2,779.88	52,748.12
账龄	2024.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	36,982.36	99.40	1,849.12	35,133.24
1-2 年	222.85	0.60	22.29	200.57
2-3 年	0.07	-	0.02	0.05
合计	37,205.29	100.00	1,871.42	35,333.86
账龄	2023.12.31			
	账面余额	占比	坏账准备	账面价值
1 年以内	32,221.74	99.23	1,611.09	30,610.65
1-2 年	248.42	0.77	24.84	223.58
2-3 年	0.07	-	0.02	0.05
合计	32,470.24	100.00	1,635.95	30,834.29

注：2023 年末，单项计提坏账准备 9.55 万元；2024 年末，核销应收账款 9.55 万元。

报告期各期末，公司应收账款账龄以 1 年以内为主，占比均在 99%以上，账龄较短，应收账款安全性高，不能收回的可能性较小。

2、主要客户

报告期各期末，公司应收账款前五大客户情况如下：

单位：万元

2026.6.30				
客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
客户 A	9,594.93	15.73%	479.75	5%
客户 C	4,344.90	7.12%	217.24	5%
矽品科技（苏州）有限公司	3,796.72	6.22%	189.84	5%
紫光展锐（上海）科技股份有限公司	3,690.38	6.05%	185.41	5%
合肥智芯半导体有限公司	3,655.35	5.99%	182.78	5%
合计	25,082.28	41.11%	1,255.01	5%
2025.12.31				
客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
客户 A	8,380.06	15.09%	419.00	5%
客户 C	5,339.80	9.62%	266.99	5%
展讯通信（上海）有限公司	4,452.83	8.02%	222.64	5%
客户 B	3,282.26	5.91%	164.11	5%

合肥智芯半导体有限公司	3,053.74	5.50%	152.69	5%
合计	24,508.69	44.14%	1,225.43	5%
2024.12.31				
客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
客户 A	8,172.45	21.97%	408.62	5%
展讯通信（上海）有限公司	2,936.18	7.89%	146.81	5%
客户 B	2,592.62	6.97%	129.63	5%
客户 C	2,100.46	5.65%	105.02	5%
无锡英迪芯微电子科技股份有限公司	1,035.55	2.78%	51.78	5%
合计	16,837.25	45.26%	841.86	5%
2023.12.31				
客户名称	账面余额	占应收账款 余额比例	坏账准备	坏账准备 计提比例
客户 B	3,570.02	10.99%	178.50	5%
紫光展锐（上海）科技有限公司	2,579.77	7.94%	128.99	5%
深圳市中兴微电子技术有限公司	2,472.37	7.61%	123.62	5%
客户 A	2,121.16	6.53%	106.06	5%
合肥智芯半导体有限公司	2,028.84	6.25%	101.44	5%
合计	12,772.17	39.32%	638.61	5%

报告期各期末，公司应收账款前五大客户的合计应收账款余额为 12,772.17 万元、16,837.25 万元、24,508.69 万元和 25,082.28 万元，占各期末应收账款余额的比例分别为 39.32%、45.26%、44.14%和 41.11%，主要应收账款对象集中度总体保持稳定。

报告期各期末，公司前五大应收账款客户均按组合计提坏账准备，坏账准备计提充分，主要客户整体信用风险可控，未发生显著异常。

3、期后回款

报告期各期末，公司应收账款账龄、期后回款情况如下：

单位：万元，%

时间	账龄	账面余额	占比	截至 2026 年 8 月 末，期后回款金额	期后回 款比例
2026 年 6 月 末	1 年以内	60,930.84	99.87	37,903.02	62.13
	1-2 年	79.58	0.13		
	合计	61,010.41	100.00		
2025 年末	1 年以内	55,458.46	99.87	53,537.47	96.42

	1-2 年	69.53	0.13		
	合计	55,527.99	100.00		
2024 年末	1 年以内	36,982.36	99.40	37,205.28	100.00
	1-2 年	222.85	0.6		
	2-3 年	0.07	-		
	合计	37,205.29	100.00		
2023 年末	1 年以内	32,221.74	99.23	32,470.24	100.00
	1-2 年	248.42	0.77		
	2-3 年	0.07	-		
	合计	32,470.24	100.00		

注：2023 年末，单项计提坏账准备 9.55 万元；2024 年末，核销应收账款 9.55 万元。

报告期各期末，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，占比分别为 99.23%、99.40%、99.87%及 99.87%。公司报告期各期末应收账款账龄结构稳定，未发生重大变化。

报告期各期末，公司应收账款期后回款比例分别为 100.00%、100.00%、96.42%及 62.13%。2024 年末，公司核销应收账款 9.55 万元，主要系诺领科技（南京）有限公司处于清算状态，相应款项无法收回。除上述情况外，公司应收账款总体回款率较高、账龄较短、坏账准备计提充分，不能收回的可能性较小。

4、同行业可比公司坏账准备计提情况

（1）3 家台资可比公司的坏账计提政策

京元电子		矽格		欣铨	
类别	计提比例	类别	计提比例	类别	计提比例
未逾期	0%	未逾期	0.001%	未披露	未披露
逾期 1-90 天	0%	逾期 30 天内	0.001%	未披露	未披露
逾期 91-180 天	1%	逾期 31-90 天内	30%	未披露	未披露
逾期 181-365 天	2%	逾期 91-180 天内	50%	未披露	未披露
逾期 366 天以上	5%	逾期 180 天以上	50%~100%	未披露	未披露

（2）发行人与内资可比公司的坏账计提政策

类别	利扬芯片	华岭股份	朗迅科技	发行人
1 年以内	3%	3%	5%	5%
1-2 年	10%	5%	10%	10%
2-3 年	30%	10%	30%	30%

类别	利扬芯片	华岭股份	朗迅科技	发行人
3-4 年	100%	50%	50%	50%
4-5 年	100%	80%	80%	80%
5 年以上	100%	100%	100%	100%

由上表可知，3 家台资可比公司的坏账计提政策与公司不一致，不具有可比性。报告期各期末，公司的应收账款基本分布在 1 年以内和 1-2 年，公司的坏账计提比例与朗迅科技一致；与利扬芯片、华岭股份 2 家内资可比公司相比，公司的坏账计提比例更加谨慎、保守。

综上，公司报告期各期末应收账款坏账准备计提充分，与同行业可比公司相比不存在重大差异。

三、报告期内公司在建工程主要项目的转固时点，是否存在应转固未及时转固的情形，并说明在建工程转固后新增产能的消化情况，是否存在固定资产闲置及减值风险

（一）报告期内公司在建工程主要项目的转固时点，是否存在应转固未及时转固的情形

报告期内，公司在建工程主要项目如下：

单位：万元

2026 年 1-6 月/2026 年 6 月末					
项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资产 金额	其他减少 金额	期末余额
测试设备	150,084.54	158,477.54	173,621.27	-	134,940.81
上海厂务工程	4,323.78	12,142.43	-	-	16,466.21
无锡厂务工程	2,729.79	960.31	820.79	217.43	2,651.89
南京厂务工程	185.67	188.22	185.67	139.51	48.71
合计	157,323.79	171,768.51	174,627.73	356.94	154,107.63
2025 年度/2025 年末					
项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资产 金额	其他减少 金额	期末余额
测试设备	55,719.28	237,998.42	143,633.16	-	150,084.54
上海厂务工程	311.91	4,291.04	-	279.17	4,323.78
无锡厂务工程	10,239.83	23,995.99	31,397.18	108.84	2,729.79
南京厂务工程	326.23	1,805.29	1,696.09	249.75	185.67
合计	66,597.25	268,090.74	176,726.44	637.76	157,323.79
2024 年度/2024 年末					

项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资产 金额	其他减少 金额	期末余额
测试设备	31,743.58	120,783.95	96,808.24	-	55,719.28
无锡厂务工程	1,431.24	10,244.09	1,014.27	421.23	10,239.83
南京厂务工程	17,690.67	8,299.15	25,177.70	485.89	326.23
合计	50,865.49	139,327.18	123,000.21	907.12	66,285.34
2023 年度/2023 年末					
项目名称	期初余额	增加金额	转入固定资产 金额	其他减少 金额	期末余额
测试设备	10,854.65	98,828.04	77,939.11	-	31,743.58
南京厂务工程	549.87	17,346.81	-	206.01	17,690.67
合计	11,404.52	116,174.85	77,939.11	206.01	49,434.25

报告期内，公司在建工程主要包括测试设备及厂务工程。具体情况如下：

1、报告期内，公司在建工程中的测试设备主要包括尚在安装或功能验证阶段的测试机、探针台、分选机和外观检查机等。报告期内，公司测试设备的转固时点为设备达到预定可使用状态，判断标准为设备完成装机且通过功能验证；测试设备转固的依据为《设备验收单》，该《设备验收单》经权责主管核准后送交财务部，财务部将《设备验收单》留存并将该设备转入固定资产核算，自验收完成次月起计提折旧。公司报告期内主要测试设备均需安装及功能验证后方可投入使用，转入固定资产的周期一般为 1-4 个月，转入固定资产的时点及时，不存在已达预定可使用状态未及时转固的情形。

2、报告期内，公司在建工程中的厂务工程的转固时点为达到预定可使用状态，判断标准为工程施工完成，并通过工程竣工验收；转固依据为《竣工验收单》，财务部留存验收资料并将对应的厂务工程转入固定资产核算，自验收完成次月起计提折旧。报告期内，公司厂务工程的转固时长主要受到项目规模大小影响，转入固定资产的依据充分，时点及时，不存在已达预定可使用状态未及时转固的情形。

综上，报告期内公司在建工程主要项目的转固时点为达到预定可使用状态，不存在应转固未及时转固的情形。

（二）说明在建工程转固后新增产能的消化情况，是否存在固定资产闲置及减值风险

报告期各期末，公司产能及营业收入情况如下：

单位：万元，万小时

项目	2026 年 1-6 月 /2026.6.30	2025 年度 /2025.12.31	2024 年度 /2024.12.31	2023 年度 /2023.12.31
产能	509.89	760.39	583.32	433.95
新增产能	259.39（年化）	177.07	149.37	67.01
产能利用率	76.67%	74.19%	76.79%	63.27%
营业收入	107,185.98	157,464.24	107,686.99	73,652.48

报告期各期末，公司产能分别为 433.95 万小时、583.32 万小时、760.39 万小时和 509.89 万小时；对应新增产能分别为 67.01 万小时、149.37 万小时、177.07 万小时和 259.39 万小时（年化）。受益于 IPO 及前次可转债募投项目、自筹资金投资项目的逐步投产，公司产能规模持续扩张，新增产能随着公司 AI 算力芯片测试等业务规模的拓展逐步消化，最近一期产能利用率达 76.67%。报告期内，公司营业收入分别为 73,652.48 万元、107,686.99 万元、157,464.24 万元和 107,185.98 万元，同比增速分别为 0.48%、46.21%、46.22%和 69.00%，营业收入亦随着产能释放实现较快增长。

报告期内，公司新增固定资产主要为高端测试设备，不存在固定资产闲置及减值的风险。

综上，公司报告期内新增产能得到有效消化，新增固定资产主要为高端测试设备，不存在闲置及减值的风险。

四、截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资，本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资

（一）截至最近一期末，公司是否持有金额较大的财务性投资

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人财务报表中可能涉及财务性投资的相关科目情况如下：

单位：万元

项目	金额	主要构成	是否属于财务性投资
交易性金融资产	6,054.62	中低风险理财产品	否
其他应收款	1,319.49	押金保证金、员工购房借款	否
其他流动资产	72,289.88	增值税待抵扣进项税	否
其他非流动金融资产	5,000.00	对江苏泰治的股权投资	否
	500.00	对芯知微的股权投资	否

项目	金额	主要构成	是否属于财务性投资
	2,865.88	对上海信邀的股权投资	是
其他非流动资产	15,144.88	预付设备工程款	否

1、交易性金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产账面价值为 6,054.62 万元，主要系公司购入的理财产品，相关理财产品明细（不含收益）具体如下：

产品名称	产品风险	本金金额 (万元)	购买日期	期限	预期年化收益率/业绩比较基准
招银理财招赢日日金 181 号现金管理类理财计划	低风险	1,000.00	2026 年 5 月 26 日	无固定期限 T+1	1.46%
省心享-华泰 WUFUND 固收私享 FOF721 号单一资产管理计划	中低风险	1,000.00	2025 年 9 月 25 日	锁定 180 天后 可赎回	2.3%-2.5%
		2,000.00	2026 年 1 月 9 日		
		1,000.00	2026 年 4 月 24 日		
国寿资产-源流 2158 保险资产管理产品	中低风险	1,000.00	2026 年 1 月 9 日	锁定 7 天后 可赎回	1.8%-2.0%

公司基于日常资金管理的目的购买理财产品，所购买的理财产品为银行现金管理类产品、券商保险固定收益类资管产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

2、其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 1,319.49 万元，主要包括日常生产经营活动相关的押金保证金及员工购房借款，不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 72,289.88 万元，主要为增值税待抵扣进项税，不属于财务性投资。

4、其他非流动金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 8,365.88 万元，主要系对江苏泰治科技股份有限公司、蚌埠芯知微电子科技有限公司和上海信邀创业投资中心（有限合伙）的股权投资。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对江苏泰治的投资账面价值为 5,000.00 万元。江苏泰治为半导体行业的智能制造解决方案服务商，公司对江苏泰治的投资属于围绕半导体产业链上游，以获取技术和业务合作为目的的产业投资，不属于财务性投资。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对芯知微的投资账面价值为 500.00 万元。芯知微主要从事集成电路芯片设计及服务，公司对芯知微的投资属于围绕半导体产业链下游客户，以加强业务合作和拓展客户渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对上海信邀的投资账面价值为 2,865.88 万元，上海信邀主要从事半导体产业链相关的股权投资业务，该笔投资属于财务性投资，占期末合并报表归属于母公司净资产 422,791.61 万元的比例为 0.68%。

5、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 15,144.88 万元，主要系预付设备工程款，不属于财务性投资。

综上，截至 2026 年 6 月 30 日，除对上海信邀的投资外，公司不存在其他财务性投资。公司财务性投资总金额 2,865.88 万元，占合并报表归属于母公司净资产 422,791.61 万元的比例为 0.68%，比例较低。

（二）本次发行董事会决议日前六个月内公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资

本次发行董事会决议日为 2026 年 5 月 8 日，本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资，具体如下：

1、投资类金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在投入类金融业务的情形，亦无拟投入类金融业务的计划。

2、非金融企业投资金融业务

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在投资金融业务的情况，亦无拟投资金融业务的计划。

3、对外股权投资

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司未新增对外股权投资，亦无新增对外股权投资的计划。

4、投资产业基金、并购基金

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形，亦无拟投资产业基金、并购基金的计划。

5、拆借资金

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在对外资金拆借情形，亦无拟实施资金拆借的计划。

6、委托贷款

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在将资金以委托贷款的形式借予他人的情况，亦无拟实施委托贷款的计划。

7、以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在集团财务公司，不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形，亦无以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的计划。

8、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融产品的计划。

五、中介机构核查情况

（一）核查程序

针对上述事项，保荐机构、申报会计师执行了以下核查程序：

- 1、获取公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月的财务报表、收入成本明细表和产能利用率明细表，对公司的业绩变动情况进行分析；
- 2、获取同行业公司的财务报表和年度报告，将公司的业绩变动情况与同行

业可比公司进行对比分析；

3、查阅相关行业研究报告，了解行业的竞争格局和发展趋势；

4、获取公司报告期各期末应收账款明细表、账龄明细表、坏账准备计提表、期后回款统计表、坏账准备计提政策，核查坏账准备计提的充分性；查阅同行业可比公司坏账准备计提政策，分析公司坏账准备计提是否审慎、合理；

5、获取公司报告期各期末在建工程明细表，并抽查在建工程转固凭证、《设备验收单》、《竣工验收单》等资料，核查在建工程转固时点的准确性；获取公司报告期内产能利用率统计表，了解公司新增产能的消化情况；

6、获取公司最近一期末交易性金融资产、其他应收款、其他非流动金融资产、其他非流动资产等科目明细，查阅投资协议等资料，了解被投资企业的业务性质和投资背景，判断公司是否存在财务性投资情况，以及本次发行董事会决议日前六个月内是否存在新投入和拟投入的财务性投资。

（二）核查结论

经核查，保荐机构、申报会计师认为：

1、报告期内，公司晶圆测试单价呈波动上升趋势，芯片成品测试单价呈先下降后回升趋势，测试总工时逐年稳定上升且产能利用率均维持在较高水平，上述因素共同驱动公司业绩高速增长；

2、2024 年度利扬芯片、华岭股份受行业周期下行影响，营业收入有所下降，公司及朗迅科技仍保持增长；2025 年以来公司与同行业可比公司营业收入均呈增长趋势，业绩变动方向一致，增速差异主要系各公司产品结构、客户结构及收入基数不同所致，与各自测试单价、测试工时及产能利用率的变化相匹配，具有合理性，公司与同行业可比公司不存在重大差异；

3、报告期内，公司综合毛利率分别为 38.96%、37.11%、39.37%和 33.59%，其中 2026 年 1-6 月综合毛利率下降较为明显，主要系行业季节性因素及新增产能爬坡影响所致；

4、报告期各期末，公司应收账款增长主要系产能扩张所致，具备合理性；公司报告期各期末应收账款坏账准备计提充分，与同行业可比公司相比不存在重

大差异；

5、报告期内，公司主要在建工程的转固时点为达到预定可使用状态，不存在应转固未及时转固的情形；公司报告期内新增产能得到有效消化，新增固定资产主要为高端测试设备，不存在闲置及减值的风险；

6、截至最近一期末，公司未持有金额较大的财务性投资。本次发行董事会决议日前六个月至本回复签署日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资。

（本页无正文，为上海伟测半导体科技股份有限公司关于《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函的回复》之签章页）

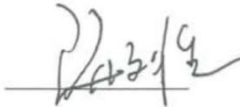
上海伟测半导体科技股份有限公司



发行人董事长声明

本人已认真阅读《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函的回复》的全部内容，确认本次回复内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性，及时性承担相应法律责任。

发行人法定代表人、董事长：


骞文胜

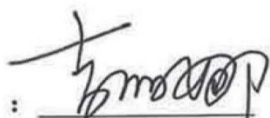
上海伟测半导体科技股份有限公司



2026年9月16日

（本页无正文，为平安证券股份有限公司关于《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函的回复》之签章页）

保荐代表人：



吉丽娜



牟军



声明

本人已认真阅读《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函的回复》的全部内容，了解本回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本回复不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

总经理签名：


李谦

董事长签名：


何之江

